



【景美科技 2026 年 半年報 暨 7 月營收新聞稿】

景美科技 (7899) 上半年 EPS 2.56 元 稅後淨利年增 163%

上半年獲利超越 2025 年全年

2026 年 8 月 11 日 / 新北市

先進製程測試介面結構件供應商 景美科技 (7899) 公告 2026 年上半年財務報告及 7 月自結營收。

● **2026 年上半年營收 逐季墊高 獲利成長幅度大於營收**

- **上半年營收：**390,246 仟元，年增 78.71% (去年同期 218,363 仟元)。
- **上半年獲利：**營業利益 81,103 仟元 (年增 97.48%)、稅後淨利 58,579 仟元 (年增 163%)、每股稅後盈餘 2.56 元 (去年同期 1.05 元)。
- **上半年獲利率：**營業利益率 20.8% (去年同期 18.8%)、稅後淨利率 15.0% (去年同期 10.2%)。

上半年營業費用率由去年同期的 24% 下降至 19%，反映營收規模放大後的費用攤提效率提升，是營業利益率與稅後淨利率同步走高的主因；上半年毛利率 39.7%，亦高於 2025 年全年的 38.4%。整體而言，獲利成長幅度明顯大於營收成長幅度。

以獲利水準觀察，上半年每股稅後盈餘 2.56 元，已高於 2025 年全年的 1.53 元與 2024 年全年的 1.80 元；稅後淨利亦達 2025 年全年的 1.78 倍，僅六個月即改寫公司歷年全年最佳獲利紀錄。

以季度觀察，2026 年第一季合併營收 179,429 仟元、第二季 210,817 仟元，第二季較第一季成長 17.49%、較去年同期成長 85.57%，成長並非來自單季或單月的短期跳升，而是逐季墊高的結構性成長。

● **2026 年 7 月營收年增 112% 連續七個月改寫同期紀錄**

- **7 月營收：**71,766 仟元，年增 112.16%，為公司單月營收次高。
- **前七月累計營收：**462,011 仟元，年增 83.20%，已相當於 2025 年全年合併營收 428,592 仟元的 108%，並為連續第七個月改寫歷年同期單月營收最高紀錄。

景美科技總經理 羅麗文 表示，探針卡結構件屬高度客製化產品，單月出貨節奏受客戶專案排程與交期安排影響，月度之間出現波動屬正常現象，採季度趨勢觀察營運體質更為客觀；就累計數字而言，全年成長動能未見改變。成長動能主要反映 AI、高效



能運算 (HPC) 與先進製程測試需求持續放大，帶動探針卡關鍵結構件、細微鑽孔件與測試機框 (Stiffener) 出貨同步成長。

● **產品組合三線並進 探針卡機框比重提升至 11%**

- **上半年產品組合：**探針卡結構組件占 48%、探針卡細微鑽孔占 26%、探針卡機框 (ATE Stiffener) 占 11%，三大探針卡相關產品線合計占營收 85%。

其中探針卡結構組件仍為公司最大宗產品線；探針卡機框比重較 2025 年的 9% 明顯提升，主要係公司於 4Q25 順利通過晶圓代工廠驗證、正式切入日系測試機框供應，並自 1Q26 起穩定出貨所致。景美科技發言人 鄭雅文 表示，今年成長並非依賴單一產品線拉抬。隨 AI 與 HPC 晶片訊號接點密度提高、單卡針數與孔位密度同步上升，導板細微鑽孔、精密結構件加工與整合組裝三大能力均出現需求成長；由於細微鑽孔多以孔數計價，針數越高、孔位越密集，對應加工價值亦隨之提高，形成具延續性的結構性成長動能。在 AI、先進封裝與高階測試需求長期成長趨勢明確下，景美科技將持續以技術領先、品質穩定與量產交付三大核心優勢，朝向全球先進製程測試介面關鍵結構件供應商目標穩健邁進。

景美科技自結營收簡表 (公開資訊觀測站公告營收)：單位：新台幣仟元；%

年度/月份	2026 年	2025 年	增減百分比
7 月	71,766	33,826	YoY +112.16%
1~7 月	462,011	252,190	YoY +83.20%

景美科技 2026 年上半年營運概況 單位：新台幣仟元；%

項目	2026 上半年	2025 上半年	增減%
營業收入	390,246	218,363	+78.71%
營業毛利	154,788	92,886	+66.64%
營業毛利率	39.7%	42.5%	-
營業利益	81,103	41,070	+97.48%
營業利益率	20.8%	18.8%	-
稅後淨利	58,579	22,276	+163%
稅後淨利率	15.0%	10.2%	-
每股稅後盈餘 (元)	2.56	1.05	+143.81%



新聞發言人：品牌 總經理 鄭雅文 winwin_cheng@cmat-tek.com.tw 0933-888-334

公司簡介：

半導體先進製程測試介面 關鍵結構件供應商 景美科技股份有限公司 (7899.TW) 於 2026 年 2 月 25 日正式登錄興櫃交易。公司成立於 2006 年，專注於半導體先進製程探針卡細微鑽孔與結構件之設計、製造與銷售，實收資本額約新台幣 2.29 億元。景美科技深耕探針卡結構件近 20 年，客戶涵蓋全球最大晶圓代工廠、歐美日韓探針卡廠及台灣前三大探針卡廠，產品包含晶圓測試(CP)用垂直式探針卡 (VPC) 與微機電探針卡 (MEMS) 之關鍵結構件，核心產品涵蓋上下導板細微鑽孔 (Upper Plate / Lower Plate) 、ATE Stiffener、Spacer、JIG、Backer 等高精度、高門檻關鍵結構件，為高階晶片測試不可或缺的重要組成。

景美科技之競爭優勢包括：1.具備完整之探針卡結構件設計與開發能力。2.兼具高強度合金金屬材料、高性能工程塑膠與複合材料之整合實力。3.以高精度組裝工藝有效控制公差累積，確保模組功能性與高度可靠性。4.具備少量多樣高客製化的彈性製造能力。5.以夥伴思維深度融入客戶供應鏈，建立互補協作模式並加速產品認證。